

新质生产力每日动态：北京发布 AI4Chip 行动计划，AI 贯穿芯片全产业链

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 8 月 25 日星期二

摘要

今天新质生产力方向的新信息集中在 AI+ 集成电路、数据要素应用、政策性融资工具和全球 AI 基础设施资本开支。北京经开区发布“AI4Chip”行动计划，到 2028 年培育 3—5 家具有国际影响力的生态领军企业、形成 10 个以上可规模化复制的标杆应用，并把 AI+EDA、AI-OPC、芯片设计智能体、制造数字孪生和高质量数据集纳入完整产业链；上海浦东公布大数据创新应用竞赛结果，86 个项目覆盖数据流通基础设施和行业应用；新一轮 8000 亿元政策性金融工具开始项目申报；nVent 宣布 17.5 亿美元收购 Maverick Power，加强 AI 数据中心配电能力；SoftBank 计划发行 1 万亿日元零售债，为 AI 投资和债务再融资筹集长期资金。技术、数据和资本正在同时成为新质生产力的重要基础设施。

目录

- 一、北京经开区发布 AI4Chip 行动计划：AI 贯穿芯片设计、制造和封测 3
- 二、浦东大数据创新应用竞赛收官：86 个项目验证数据要素真实场景 3

三、新一轮 8000 亿元政策性金融工具启动项目申报：项目资本金获得新增来源	4
四、nVent 17.5 亿美元收购 Maverick Power：AI 数据中心投资扩散到配电设备	4
五、SoftBank 计划发行 1 万亿日元零售债：AI 竞争越来越需要长期资金	5
趋势观察	5
参考资料	6

一、北京经开区发布 AI4Chip 行动计划：AI 贯穿芯片设计、制造和封测

北京经济技术开发区 8 月 24 日公开《“AI4Chip”人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026—2028 年）》。文件提出，到 2028 年构建较完整的集成电路与人工智能融合创新体系，培育 3—5 家具有国际影响力的 AI4Chip 生态领军企业，形成 10 个以上可规模化复制的标杆应用。

计划覆盖了完整芯片产业链。设计端包括 AI+EDA、IP 自动生成、PDK 校准验证、DTCO/STCO 和芯片设计智能体；制造端包括 AI-OPC、制造数字孪生、CIM 和智能测试；同时部署专业算力集群、集成电路高质量数据集、行业垂直智能体以及中试验证平台。

这份政策的意义在于，它没有把“人工智能产业”和“集成电路产业”分开支持，而是把 AI 作为芯片产业的工程工具。EDA、工艺、良率、材料和测试都高度依赖工程数据和仿真，这也是 AI 真正能够提高研发效率的地方。

二、浦东大数据创新应用竞赛收官：86 个项目验证数据要素真实场景

上海市政府 8 月 24 日发布第八届浦东新区大数据创新应用竞赛结果。赛事共有 70 余家机构、400 余人参与，形成 86 个项目，设置数据要素创新应用和数据流通基础设施两个赛道，并与上海“数据要素 ×”大赛形成联动。

项目已经明显超过传统数据可视化比赛。亿通国际“沪关 e 单通”利用区块链做跨境贸易单证可信流转；衍因科技把“AI 科学家智能体 + 具身机器人”用于科研干湿实验闭环；此外还有无人机巡检高质量数据集、遥

感灾害分析、中医药 AI 筛选等方案。

数据要素真正产业化，需要回答的是数据如何进入业务、如何被可信调用、如何产生收益。浦东的做法说明地方数据政策开始从建设交易平台，进一步走向应用验证和产业化筛选。

三、新一轮 8000 亿元政策性金融工具启动项目申报：项目资本金获得新增来源

Reuters 8 月 24 日报道，中国新一轮规模约 8000 亿元人民币、约 1190 亿美元的政策性金融工具已开始项目申报，各地正在汇总符合条件的项目。其核心用途之一是补充项目资本金，再撬动银行贷款和社会资本进入基础设施及战略产业项目。

这一规模高于去年的 5000 亿元工具。国家发展改革委此前已经部署加快相关政策工具落地，并强调进一步支持民间投资和重点项目建设。

先进制造、能源基础设施、数据中心和未来产业项目往往不是没有贷款需求，而是资本金比例和长期融资结构难以满足要求。政策性金融工具如果能够更快进入项目资本层，就能放大银行和社会资金的投资能力。

四、nVent 17.5 亿美元收购 Maverick Power：AI 数据中心投资扩散到配电设备

nVent Electric 8 月 24 日宣布，以 17.5 亿美元基础交易价格收购 Maverick Power，并设置最高约 5.5 亿美元的未来业绩追加对价。Maverick 主要提供数据中心和关键基础设施所需的开关设备、配电盘和模块化电力系统，预计 2026 年营收约 7 亿美元。

AI 数据中心的资本焦点正在从 GPU 扩展到配电、变压器、冷却、机柜和网络基础设施。随着单个 AI 集群功率越来越大，电力设备交期和工

程能力逐渐成为数据中心扩建速度的重要约束。

这类并购说明 AI 基础设施已经形成明显的上游外溢。传统电气和工业基础设施企业正在因为 AI 算力扩张获得新的市场增量，新质生产力的资本链由数字技术进一步延伸到实体设备。

五、SoftBank 计划发行 1 万亿日元零售债：AI 竞争越来越需要长期资金

Wall Street Journal 8 月 24 日报道，SoftBank 计划发行规模 1 万亿日元、约 63 亿美元的七年期零售债券，票面利率指导区间为 4.3%—4.9%，计划 9 月 4 日定价。资金将支持 AI 投资，同时用于部分债务再融资。

SoftBank 持续加大对 OpenAI 及 AI 基础设施的投入，这意味着其融资结构也需要适应更长投资周期。通过日本零售债市场获得长期资金，可以减少短期融资错配，但更高利率也意味着 AI 项目未来必须创造足够回报。

AI 过去被视为软件业务，今天却越来越像基础设施行业：训练集群、电力和数据中心都需要巨额前置资本。模型竞争之外，谁能获得更长期、更低成本的资本，已经开始成为产业竞争力的一部分。

趋势观察

今天几条信息分别对应技术、数据和资本三层。北京经开区把 AI 嵌入芯片工程流程，浦东让数据要素进入真实场景，8000 亿元政策性金融工具补项目资本金，nVent 和 SoftBank 则显示全球 AI 投资正在同时拉动工业电气设备和长期融资。

新质生产力进入“十五五”开局阶段后，评价体系会越来越实：是否形成可复用的工程工具，数据是否真正参与生产，技术项目是否拿得到中

长期资金，产业链是否出现订单和投资增量。只有这些要素同时形成闭环，AI 和未来产业才能从政策概念转成持续生产力。

参考资料

1. 北京经济技术开发区 | 《“AI4Chip” 人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026—2028 年）》 | 2026-08-24 | 核验 AI4Chip 目标与任务。
2. 北京经济技术开发区 | AI4Chip 相关政策资料 | 2026-08-24 | 补充集成电路 AI 融合背景。
3. 上海市人民政府 | 《第八届浦东新区大数据创新应用竞赛在张江落幕》 | 2026-08-24 | 核验 86 个项目及具体案例。
4. 上海数据要素相关公开资料 | 2026 年 | 补充数据流通与“数据要素×”背景。
5. Reuters | 《China's \$119 billion policy financing tool begins project applications...》 | 2026-08-24 | 核验 8000 亿元政策性金融工具。
6. 国家发展改革委 | 扩大有效投资及政策性金融工具相关部署 | 2026-08-17 | 补充官方政策背景。
7. 新华社 / 经济参考报 | 政策性金融工具与民间投资相关报道 | 2026-08-17 | 补充资本金和项目支持机制。
8. nVent | 《nVent to Acquire Maverick Power》 | 2026-08-24 | 核验 17.5 亿美元收购。
9. Reuters | 《nVent Electric to buy Maverick Power for \$1.75 billion...》 | 2026-08-24 | 独立核验 AI 数据中心电力基础设施趋势。

10. The Wall Street Journal | 《SoftBank Plans Record Retail Bond Issuance Amid AI Push》 | 2026-08-24 | 核验 1 万亿日元零售债计划。

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>